

Metal Bond Blades

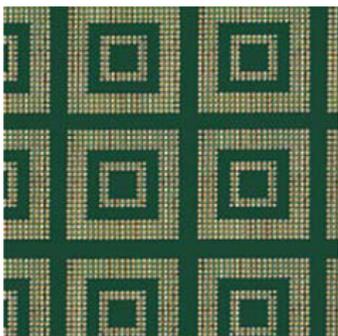
B1A SERIES

因具有高耐磨性与高刚性，适用于难加工材料的精密加工

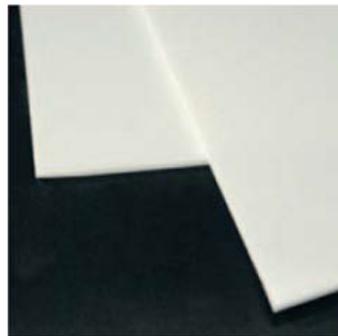
适用于难加工材料精密加工的B1A系列切割刀片

该系列产品是在结合剂中添加金属粉末的烧结型金刚石切割刀片。因为该切割刀片对磨粒的保持力强，故其耐磨损性能高，所以适合于电子组件及光学零部件等的精密切割及开槽加工。另外，由于其同时具备了优良的切割能力及高刚性，能够有效地减少切割刀片的倾斜切割等不良切割现象，因此也适用于切割加工以各种陶瓷材料及CSP为代表的半导体封装组件。

- 因具有高耐磨性与高刚性，适用于难加工材料的精密加工
- 切割刀片刚性高，可以抑制倾斜切割及蛇形切割等不良加工现象的发生
- 结合剂品种丰富，可适用于玻璃，晶粒级封装（CSP）等不同材料的切割加工
- 通过精确的集中度调整，可以有效控制加工质量及使用寿命



晶粒级封装（CSP）



陶瓷

加工对象

电子元件、光学零部件、各种半导体封装元件、陶瓷、单晶铁氧体、玻璃及其他多种材料

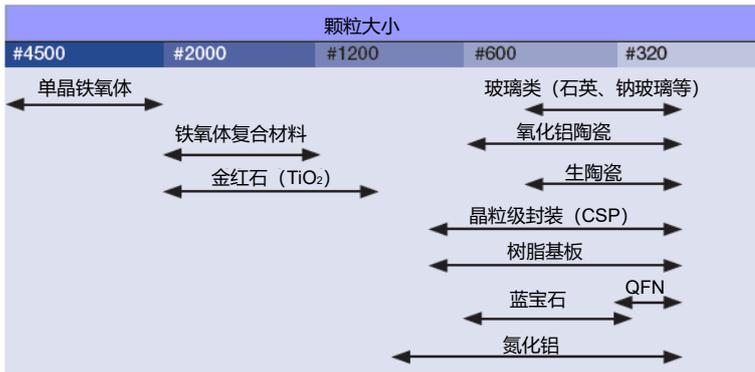
加工参数

不同结合剂的磨损量比较



上表为切割磨刀板时的磨损倾向。仅作为参考标准，有时由于工作物及加工条件不同，可能与上表数据有所出入。

不同颗粒大小的应用实例



技术规格

厚度精度^{※4}
标准精度^{※5}
±0.005
±0.002 (mm)

集中度
25 低
50
75
100
125 高

制造分类^{※3} 结合度^{※3} 结合剂^{※3}

※1 B 1E8 6 3 S3 SD 600 L 50 MT38

54 × 0.15 × 40 × 45°

外径 厚度 内径 刀刃角度 θ

形状 ^{※2}	切口 ^{※6}	磨粒种类	颗粒大小
1A8	S1 切口数量 4 深度 1 mm	SD 人造金刚石 (钻石)	320 #320
1E8	S2 切口数量 8 深度 1 mm	SDC 镀膜人造金刚石 (钻石)	360 #360
1M8	S3 切口数量 16 深度 1 mm	B 氮化硼 (cBN)	400 #400
1N8	S5 切口数量 40 深度 1 mm	BC 镀膜氮化硼 (镀膜cBN)	500 #500
1V8	SS 特殊规格		600 #600
			800 #800
			1000 #1000
			1200 #1200
			1500 #1500
			1700 #1700
			2000 #2000
			3000 #3000
			4000 #4000
			5000 #5000
			6000 #6000

※3 关于组合方式制造分类及结合度分别与其各自的结合剂相对应。

制造分类	结合度	结合剂	厚度精度
0	N	M42	1, 2, 3
		M51	
6	L	MT08	
		MT38	
		MX64	2, 3
		MT05	
P		MT18	
		MT60	

※4 可对应精度随品种、尺寸而变化。
※5 标准精度随品种、尺寸而变化。

※1 包括特殊规格在 内的产品，有时会以MBT-****表示。
※2 1A8以外的形状，刀片厚度大于0.1mm 时方可使用。
※6 切口宽度均为0.5 mm (SS除外)。

本公司的所有产品都已加入产品赔偿责任保险。

下订单时

在下订单时，请用户将产品的类型名称、外径、研削磨轮直径及数量通知本公司，另外在初次订购时，本公司销售窗口会根据不同加工要求，协助用户选择适合的产品。届时请一并提供研削材料、尺寸、形状、所用设备(装置)及其它相关加工条件等数据。
· 为了改进产品，本公司可能在未通知用户的情况下，就对产品规格进行变更，因此请仔细核对规格后再下订单。



为了安全使用本公司的各种产品 为了预防发生因研削磨轮、切割刀片(以下通称精密加工刀具)的破损而造成的各种事故和人身伤害，请严格遵守下列各注意事项。

- 请使用安全挡板 (包括喷嘴外壳或外盖)。
- 在使用注有限制旋转数的精密加工刀具时，请不要超出其规定的旋转数范围。
- 在安装精密加工刀具时，请遵照设备(装置)使用说明书的规定，正确地进行安装。
- 请不要使精密加工刀具掉落地上，或发生碰撞。
- 在每次使用精密加工刀具前必须先进行检查，如果有缺口或其他破损，请停止使用
- 在开始使用前，请先仔细阅读相关设备(装置)的使用说明书。
- 请不要使用经过改装的设备(装置)。
- 请不要使用不符合设备(装置)指定尺寸的精密加工刀具。
- 除了研削、切割及切削作业以外，请不要使用在其他用途。
- 在使用湿式研削、切割用精密加工刀具时，请使用冷却液。